

2024-2030年中国汽车芯片 行业发展态势与行业竞争对手分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国汽车芯片行业发展态势与行业竞争对手分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/413098.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

半导体芯片在汽车领域的用途非常广泛，除了常见的多媒体娱乐系统、智能钥匙和自动泊车系统外，芯片还广泛应用在汽车发动机和变速箱控制系统、安全气囊、驾驶辅助系统、电动助力转向、ABS、电子稳定性系统（ESP）、行人保护、胎压控制、电动车窗、灯光控制、空调系统、座椅调节系统中，堪称汽车的神经。汽车芯片主要分为三类：第一类负责算力，比如自动驾驶系统以及发动机、底盘和车身控制等；第二类负责功率转换，比如电源和接口等；第三类是传感器，比如用在汽车雷达、气囊、胎压检测等。本轮芯片短缺主要集中在电子稳定程序和电子控制系统等中高端芯片方面。

汽车芯片产业链涉及多个行业和企业，上游的重点企业有原材料企业东京应化、晶瑞股份、日本信越等，芯片制造设备企业晶盛机电、日立科技等，远景制造企业台积电、格罗方德等；中游汽车芯片制造重点企业有瑞萨电子、赛灵思、德州仪器、意法半导体、英飞凌等；下游的重点企业则主要为车载仪器、系统及整车制造领先企业。整体来看，汽车芯片产业链的重点企业基本为国外企业，国内的领先企业数量很少。

随着新能源汽车渗透率不断上涨，全球车规级MCU市场规模也随之增长。2021年，汽车MCU市场规模大幅增长23%，达到76.1亿美元；2021年中国车载芯片MCU市场规模达30.01亿美元，同比增长13.59%，预计2025年市场规模将达42.74亿美元。

近年来，中国汽车芯片行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励汽车芯片行业发展，为汽车芯片行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出将着力推动车控操作系统及计算平台、车规级芯片等自动驾驶技术和装备研制。2021年9月，工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会四部门联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》，提出加快发展战略性新兴产业，提升新能源汽车和智能网联汽车关键零部件、汽车芯片、基础材料、软件系统等产业链水平。

汽车产业60-70%的技术创新都是由汽车电子技术推动的，而芯片是设备智能化的核心。随着汽车智能化、车联网、安全汽车和新能源汽车时代的到来，汽车芯片的使用将更加广泛。我国提出的“制造2025”、“中国芯”等政策，芯片进口替代需求强烈，政府大力支持国内厂商自主研发芯片，获取产业链上高附加值，未来自主研发汽车芯片企业有望实现突破，打入国际主流厂商供应链，逐步取代进口芯片。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国汽车芯片行业发展态势与行业竞争对手分析报告》共十一章。首先介绍了汽车半导体及全球汽车芯片行业的发展状况，接着分析了中国汽车芯片行业的总体发展及其产业链的发展情况，然后报告对汽车芯片主要应用市场、相关产业汽车电

子行业的发展进行了详尽的剖析。最后，报告对国内外汽车芯片重点企业的经营情况进行了深入的分析，并对行业的投资机遇和未来前景进行了科学的展望。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工信部、中国海关总署、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对汽车芯片业有个系统深入的了解、或者想投资汽车芯片产业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具

报告目录：

第一章 2021-2023年汽车半导体行业发展综合分析

1.1 汽车半导体基本概述

1.1.1 汽车半导体发展历程

1.1.2 汽车半导体基本要求

1.1.3 汽车半导体主要类型

1.1.4 汽车半导体产业链条

1.1.5 汽车半导体价值构成

1.2 全球汽车半导体行业发展现状

1.2.1 汽车半导体市场规模

1.2.2 汽车领域半导体收入

1.2.3 汽车半导体产品结构

1.2.4 汽车半导体区域分布

1.2.5 汽车半导体竞争格局

1.2.6 汽车半导体应用占比

1.2.7 美国汽车半导体发展

1.2.8 欧洲汽车半导体市场

1.2.9 日韩汽车半导体市场

1.3 中国汽车半导体行业发展态势

1.3.1 汽车半导体市场规模

1.3.2 汽车半导体主要企业

1.3.3 中国汽车半导体实力

1.3.4 汽车半导体需求前景

1.3.5 汽车半导体发展问题

1.3.6 汽车半导体发展建议

1.4 中国汽车功率半导体行业发展状况

1.4.1 功率半导体主要类型

1.4.2 IGBT生产工艺演变分析

1.4.3 IGBT典型应用场景分析

1.4.4 IGBT市场竞争格局分析

1.4.5 MOSFET市场竞争格局

1.4.6 功率半导体发展机遇

第二章 2021-2023年全球汽车芯片行业发展状况

2.1 2021-2023年全球汽车芯片市场运行分析

2.1.1 汽车芯片发展现状

2.1.2 汽车芯片市场规模

2.1.3 汽车芯片区域分布

2.1.4 汽车芯片市场结构

2.1.5 汽车芯片竞争格局

2.1.6 汽车芯片价格变动

2.1.7 汽车芯片供需分析

2.1.8 汽车芯片发展态势

2.2 全球汽车芯片细分领域发展现状

2.2.1 功能芯片领域

2.2.2 主控芯片领域

2.2.3 存储芯片领域

2.2.4 通信芯片领域

2.2.5 功率芯片领域

2.3 全球各地区汽车芯片市场发展动态

2.3.1 美国

2.3.2 欧洲

2.3.3 亚洲

2.3.4 日本

2.4 全球汽车芯片短缺状况及影响分析

2.4.1 全球汽车芯片短缺现状

2.4.2 芯片短缺对车企的影响

2.4.3 汽车芯片短缺原因分析

2.4.4 汽车芯片短缺应对措施

第三章 2021-2023年中国汽车芯片行业发展环境分析

3.1 经济环境

3.1.1 宏观经济运行

3.1.2 工业经济运行

3.1.3 固定资产投资

3.1.4 宏观经济展望

3.1.5 宏观趋势分析

3.2 政策环境

3.2.1 汽车半导体政策

3.2.2 产业创新战略联盟

3.2.3 汽车芯片扶持政策

3.2.4 人大代表相关建议

3.2.5 新能源车发展规划

3.2.6 智能网联汽车政策

3.3 汽车工业运行

3.3.1 行业发展形势

3.3.2 汽车产销规模

3.3.3 新能源汽车市场

3.3.4 外贸市场状况

3.3.5 汽车企业业绩

3.3.6 发展前景展望

3.4 社会环境

3.4.1 智能网联汽车发展

3.4.2 新能源汽车智能化

3.4.3 疫情极端事件影响

第四章 2021-2023年中国汽车芯片行业发展分析

4.1 中国汽车芯片行业重要性分析

4.1.1 汽车芯片主要类型

- 4.1.2 汽车芯片行业地位
- 4.1.3 汽车芯片自主可控
- 4.1.4 汽车芯片发展形势
- 4.1.5 汽车芯片发展必要性
- 4.2 2021-2023年中国汽车芯片市场现状
 - 4.2.1 汽车芯片使用数量
 - 4.2.2 汽车芯片市场规模
 - 4.2.3 国产汽车芯片现状
 - 4.2.4 汽车芯片供需状况
 - 4.2.5 汽车芯片的标准化
 - 4.2.6 汽车芯片协同发展
- 4.3 中国汽车芯片市场短缺现状分析
 - 4.3.1 汽车芯片短缺现状
 - 4.3.2 芯片短缺影响分析
 - 4.3.3 国产汽车芯片问题
 - 4.3.4 汽车芯片短缺反思
- 4.4 2021-2023年中国汽车芯片市场竞争形势
 - 4.4.1 汽车芯片相关企业数量
 - 4.4.2 汽车芯片产业区域分布
 - 4.4.3 汽车芯片厂商布局现状
 - 4.4.4 汽车厂商芯片领域布局
 - 4.4.5 汽车芯片赛道竞争态势
 - 4.4.6 汽车芯片国产替代加速
 - 4.4.7 汽车芯片未来竞争格局
- 4.5 中国汽车微控制器（MCU）市场现状分析
 - 4.5.1 MCU在汽车上的应用
 - 4.5.2 MCU芯片市场规模分析
 - 4.5.3 国内MCU产品结构分析
 - 4.5.4 国内MCU市场竞争格局
 - 4.5.5 MCU市场应用领域占比
 - 4.5.6 汽车MCU短缺现状分析
 - 4.5.7 汽车MCU短缺核心原因

- 4.5.8 MCU短缺预计持续时间
- 4.6 中国汽车芯片技术发展状况
 - 4.6.1 汽车芯片工艺要求
 - 4.6.2 汽车芯片技术标准
 - 4.6.3 汽车芯片研发周期
 - 4.6.4 车规级芯片技术现状
 - 4.6.5 汽车芯片创新路径
- 4.7 中国汽车芯片行业发展困境分析
 - 4.7.1 汽车芯片发展痛点
 - 4.7.2 车规级芯片亟待突破
 - 4.7.3 汽车芯片自给率不足
- 4.8 中国汽车芯片市场对策建议分析
 - 4.8.1 构建汽车芯片产业生态
 - 4.8.2 汽车芯片产业发展建议
 - 4.8.3 精准扶持汽车芯片产业
 - 4.8.4 汽车芯片产业发展路径

第五章 中国汽车芯片产业链发展解析

- 5.1 汽车芯片产业链发展综述
 - 5.1.1 汽车芯片产业链结构分析
 - 5.1.2 汽车芯片产业链企业图谱
 - 5.1.3 汽车芯片产业链区域分布
 - 5.1.4 汽车芯片产业链自给能力
 - 5.1.5 芯片短缺对产业链的影响
 - 5.1.6 汽车芯片产业链价格波动
 - 5.1.7 汽车芯片产业链发展建议
- 5.2 汽车芯片行业供应链发展分析
 - 5.2.1 汽车工业供应链变革
 - 5.2.2 芯片企业供应链节奏
 - 5.2.3 汽车芯片供应链问题
 - 5.2.4 汽车企业供应链管理
- 5.3 汽车芯片上游材料及设备市场分析

- 5.3.1 半导体材料的主要类型
- 5.3.2 芯片短缺对光刻胶的影响
- 5.3.3 车用8英寸晶圆产能不足
- 5.3.4 晶圆代工厂扩产规划部署
- 5.3.5 晶圆代工厂商扩产的风险
- 5.3.6 半导体设备行业发展机遇
- 5.4 汽车芯片中游制造产业分析
 - 5.4.1 汽车芯片产能现状分析
 - 5.4.2 汽车芯片制造模式分析
 - 5.4.3 汽车芯片制造商议价能力
 - 5.4.4 芯片代工封测端景气度
- 5.5 汽车芯片下游应用市场需求分析
 - 5.5.1 行业应用领域
 - 5.5.2 整车制造市场
 - 5.5.3 新能源车市场
 - 5.5.4 自动驾驶市场

第六章 2021-2023年汽车芯片主要应用市场发展分析

- 6.1 ADAS领域
 - 6.1.1 ADAS行业发展现状
 - 6.1.2 ADAS行业发展规模
 - 6.1.3 ADAS的产品渗透率
 - 6.1.4 ADAS供应商布局情况
 - 6.1.5 ADAD芯片发展动态
 - 6.1.6 ADAS融合趋势分析
- 6.2 汽车传感器领域
 - 6.2.1 汽车传感器主要类型
 - 6.2.2 各类车载雷达市场规模
 - 6.2.3 车载摄像头市场规模
 - 6.2.4 汽车传感器芯片需求
 - 6.2.5 CMOS图像传感器芯片
 - 6.2.6 汽车导航定位芯片分析

6.2.7 汽车车载雷达芯片分析

6.3 智能座舱领域

6.3.1 智能座舱产业链结构

6.3.2 智能座舱市场规模分析

6.3.3 车企智能座舱产品配置

6.3.4 智能座舱芯片发展现状

6.3.5 智能座舱芯片参与主体

6.3.6 智能座舱芯片竞争格局

6.3.7 智能座舱行业发展趋势

6.4 车联网领域

6.4.1 车联网行业利好政策

6.4.2 车联网市场规模分析

6.4.3 车联网产业区域布局

6.4.4 车联网市场竞争格局

6.4.5 车联网产业发展前景

6.4.6 车联网下芯片需求趋势

6.5 自动驾驶领域

6.5.1 自动驾驶等级及产业链

6.5.2 自动驾驶芯片发展现状

6.5.3 自动驾驶芯片供应链

6.5.4 自动驾驶芯片竞争格局

6.5.5 自动驾驶处理器芯片

6.5.6 自动驾驶AI芯片动态

6.5.7 国产自动驾驶芯片机遇

6.5.8 芯片未来竞争格局预判

第七章 2021-2023年中国汽车电子市场发展分析

7.1 中国汽车电子行业发展概述

7.1.1 汽车电子产业链

7.1.2 汽车电子驱动因素

7.1.3 汽车电子发展特点

7.1.4 汽车智能计算平台

- 7.1.5 智能座舱率先落地
- 7.2 2021-2023年中国汽车电子市场发展分析
 - 7.2.1 汽车电子成本
 - 7.2.2 市场规模现状
 - 7.2.3 市场结构分析
 - 7.2.4 汽车电子渗透率
- 7.3 汽车电子市场竞争分析
 - 7.3.1 一级供应商市场格局
 - 7.3.2 新车ADAS系统格局
 - 7.3.3 车身电子竞争现状
 - 7.3.4 车载电子系统竞争
 - 7.3.5 区域竞争格局分析
- 7.4 汽车电子市场发展存在的问题
 - 7.4.1 汽车电子标准化问题
 - 7.4.2 汽车电子技术发展问题
 - 7.4.3 汽车电子行业应用问题
- 7.5 中国汽车电子市场发展策略及建议
 - 7.5.1 汽车电子行业政策建议
 - 7.5.2 汽车电子产业发展建议
 - 7.5.3 汽车电子企业发展建议
 - 7.5.4 汽车电子供应链建设策略
- 7.6 中国汽车电子市场前景展望
 - 7.6.1 汽车电子外部形势
 - 7.6.2 汽车电子发展前景
 - 7.6.3 汽车电子发展机遇
 - 7.6.4 汽车电子发展趋势
 - 7.6.5 关键技术应用趋势
 - 7.6.6 汽车电子发展方向

第八章 2020-2023年国外汽车芯片重点企业经营分析

- 8.1 博世集团（Bosch）
 - 8.1.1 企业发展概况

- 8.1.2 汽车芯片布局
- 8.1.3 企业合作动态
- 8.1.4 芯片项目动态
- 8.1.5 极端事件影响
- 8.1.6 2021年企业经营状况分析
- 8.1.7 2022年企业经营状况分析
- 8.1.8 2023年企业经营状况分析
- 8.2 美国微芯科技公司
- 8.2.1 企业发展概况
- 8.2.2 2021财年企业经营状况分析
- 8.2.3 2022财年企业经营状况分析
- 8.2.4 2023财年企业经营状况分析
- 8.3 瑞萨电子株式会社
- 8.3.1 企业发展概况
- 8.3.2 汽车芯片业务
- 8.3.3 2021年企业经营状况分析
- 8.3.4 2022年企业经营状况分析
- 8.3.5 2023年企业经营状况分析
- 8.4 恩智浦 (NXP Semiconductors N.V.)
- 8.4.1 企业发展概况
- 8.4.2 2021财年企业经营状况分析
- 8.4.3 2022财年企业经营状况分析
- 8.4.4 2023财年企业经营状况分析
- 8.5 英飞凌科技公司 (Infineon Technologies AG)
- 8.5.1 企业发展概况
- 8.5.2 2021财年企业经营状况分析
- 8.5.3 2022财年企业经营状况分析
- 8.5.4 2023财年企业经营状况分析
- 8.6 意法半导体 (ST Microelectronics N.V.)
- 8.6.1 企业发展概况
- 8.6.2 企业融资动态
- 8.6.3 2021财年企业经营状况分析

- 8.6.4 2022财年企业经营状况分析
- 8.6.5 2023财年企业经营状况分析
- 8.7 德州仪器（Texas Instruments）
 - 8.7.1 企业发展概况
 - 8.7.2 2021年企业经营状况分析
 - 8.7.3 2022年企业经营状况分析
 - 8.7.4 2023年企业经营状况分析
- 8.8 安森美半导体（On Semiconductor）
 - 8.8.1 企业发展概况
 - 8.8.2 汽车芯片业务
 - 8.8.3 2021财年企业经营状况分析
 - 8.8.4 2022财年企业经营状况分析
 - 8.7.4 2023年企业经营状况分析

第九章 2020-2023年中国汽车芯片重点企业运营分析

- 9.1 比亚迪半导体股份有限公司
 - 9.1.1 企业发展概况
 - 9.1.2 企业经营状况
 - 9.1.3 汽车芯片业务
 - 9.1.4 企业竞争优势
 - 9.1.5 企业融资进展
 - 9.1.6 企业创新潜力
- 9.2 北京地平线机器人技术研发有限公司
 - 9.2.1 企业发展概况
 - 9.2.2 汽车芯片业务
 - 9.2.3 车企战略合作
 - 9.2.4 企业合作动态
 - 9.2.5 企业融资动态
 - 9.2.6 企业技术优势
- 9.3 北京四维图新科技股份有限公司
 - 9.3.1 企业发展概况
 - 9.3.2 经营效益分析

9.3.3 业务经营分析

9.3.4 财务状况分析

9.3.5 核心竞争力分析

9.3.6 公司发展战略

9.3.7 未来前景展望

9.4 闻泰科技股份有限公司

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 芯片业务发展

9.4.3 企业投资动态

9.4.4 经营效益分析

9.4.5 业务经营分析

9.4.6 财务状况分析

9.4.7 核心竞争力分析

9.4.8 公司发展战略

9.4.9 未来前景展望

9.5 上海韦尔半导体股份有限公司

9.5.1 企业发展概况

9.5.2 经营效益分析

9.5.3 业务经营分析

9.5.4 财务状况分析

9.5.5 核心竞争力分析

9.5.6 公司发展战略

9.5.7 未来前景展望

9.6 中芯国际集成电路制造有限公司

9.6.1 企业发展概况

9.6.2 经营效益分析

9.6.3 业务经营分析

9.6.4 财务状况分析

9.6.5 核心竞争力分析

9.6.6 公司发展战略

9.6.7 未来前景展望

9.7 嘉兴斯达半导体股份有限公司

- 9.7.1 企业发展概况
- 9.7.2 经营效益分析
- 9.7.3 业务经营分析
- 9.7.4 财务状况分析
- 9.7.5 核心竞争力分析
- 9.7.6 公司发展战略
- 9.7.7 未来前景展望
- 9.8 珠海全志科技股份有限公司
 - 9.8.1 企业发展概况
 - 9.8.2 经营效益分析
 - 9.8.3 业务经营分析
 - 9.8.4 财务状况分析
 - 9.8.5 核心竞争力分析
 - 9.8.6 公司发展战略
 - 9.8.7 未来前景展望

第十章 中国汽车芯片行业投资潜力分析

- 10.1 中国汽车芯片行业投融资现状分析
 - 10.1.1 汽车芯片融资现状
 - 10.1.2 资本加大投资力度
 - 10.1.3 汽车芯片技术投资
 - 10.1.4 汽车芯片并购态势
- 10.2 中国汽车芯片投资机遇分析
 - 10.2.1 产业链投资机遇
 - 10.2.2 汽车芯片介入时机
 - 10.2.3 汽车芯片投资方向
 - 10.2.4 汽车芯片投资前景
 - 10.2.5 汽车芯片投资建议
- 10.3 中国汽车芯片产业投融资动态
 - 10.3.1 东风汽车
 - 10.3.2 芯驰科技
 - 10.3.3 曦华科技

- 10.3.4 杰开科技
- 10.3.5 国科天迅
- 10.3.6 黑芝麻智能科技
- 10.4 中国汽车芯片细分领域投资机会
 - 10.4.1 MCU投资机会
 - 10.4.2 SoC投资机会
 - 10.4.3 存储芯片机会
 - 10.4.4 功率半导体机会
 - 10.4.5 传感器芯片机会
- 10.5 汽车芯片行业投资壁垒分析
 - 10.5.1 汽车半导体进入壁垒
 - 10.5.2 汽车半导体主要标准
 - 10.5.3 汽车半导体资金壁垒
 - 10.5.4 汽车电子芯片投资壁垒
 - 10.5.5 汽车芯片行业进入壁垒

第十一章 2024-2030年中国汽车芯片产业未来发展前景展望

- 11.1 全球汽车芯片产业发展前景及趋势预测
 - 11.1.1 全球汽车芯片需求前景
 - 11.1.2 全球汽车芯片规模预测
 - 11.1.3 汽车芯片供需状况预测
 - 11.1.4 全球汽车芯片发展趋势
- 11.2 中国汽车芯片产业发展前景及趋势分析
 - 11.2.1 汽车芯片短缺带来的机遇
 - 11.2.2 国产汽车芯片发展前景
 - 11.2.3 汽车MCU市场应用前景
 - 11.2.4 汽车芯片行业发展机遇
 - 11.2.5 汽车芯片行业发展趋势
- 11.3 对2024-2030年中国汽车芯片行业预测分析
 - 11.3.1 2024-2030年中国汽车芯片行业影响因素分析
 - 11.3.2 2024-2030年中国汽车芯片市场规模预测
 - 11.3.3 2024-2030年中国MCU市场规模预测

图表目录

- 图表 汽车半导体发展历程
- 图表 汽车半导体类别
- 图表 汽车半导体一级、二级分类
- 图表 汽车半导体产业链
- 图表 汽车半导体代表公司
- 图表 汽车半导体构成
- 图表 不同自动化程度的单车半导体平均价值
- 图表 不同电气化程度的单车半导体平均价值
- 图表 2018-2026年全球汽车半导体市场规模及预测情况
- 图表 2020-2030年全球主要汽车芯片类型市场收入及其预测
- 图表 2020年全球汽车半导体细分类型占比情况
- 图表 2020年全球汽车半导体生市场份额分布状况
- 图表 2020年全球汽车半导体市场份额
- 图表 2020年全球汽车半导体细分应用领域占比
- 图表 2000-2020年美国在半导体行业的研发支出
- 图表 美国各行业研发支出占销售额的百分比
- 图表 按国家划分的半导体研发支出占销售额的百分比
- 图表 美国半导体制造业分布
- 图表 2010-2021年日本半导体相关出口增长状况
- 图表 2021-2025年中国汽车半导体市场规模预测
- 图表 中国汽车半导体企业
- 图表 中国汽车半导体在各领域的差距和自主率情况
- 图表 L1-L5各级别自动驾驶所需各类传感器的数量
- 图表 L3不同级别自动驾驶汽车的半导体增量成本构成
- 图表 2015-2040年中国智能驾驶汽车渗透率
- 图表 功率半导体原理
- 图表 功率半导体功能
- 图表 功率半导体器件分立器件类别
- 图表 功率半导体主要参数对比
- 图表 IGBT生产制造流程

图表 IGBT芯片技术发展

图表 IGBT的主要应用领域

图表 2020年中国IGBT市场下游应用占比

图表 2020年全球IGBT分立器件市场格局

图表 2020年全球IGBT模块市场格局

图表 2020年全球MOSFET市场竞争格局

图表 国内主要MOSFET厂商

图表 2011-2020年全球汽车销量及增长情况

图表 2012-2020年全球汽车芯片行业市场规模及增长情况

图表 传统燃油车芯片细分应用占比

图表 纯电动汽车芯片细分应用占比

图表 全球汽车芯片市场格局

图表 汽车智能芯片对比

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/413098.html>